

LITERATURVERZEICHNIS

In diesem Verzeichnis wird sowohl die von den Autoren dieses Leitfadens als auch andere in den letzten Jahren veröffentlichte relevante, teilweise auch über die Thematik des Beschichten und Vergießen von elektronischen Baugruppen hinausführende Literatur aufgeführt. Bei der aufgelisteten Literatur wird allerdings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.

[Aßf04]	C. Aßfalg, „Reinigung und Bleifrei: Neuester Stand“, Productronic, Heft 5-6 (2004) 22-24.
[Asy06]	Seminar-CD zu Asymtek-Technology Days Juni 2006 mit Beiträgen von E. Vanlathem (Dow Corning), I. Sheiham (Beck), J. Mycke (Asymtek), M. Kaing (HumiSeal), S. Schröder (Peters), A. Hilton (Emerson & Cuming), I. Wilding, (Henkel), K.-F. Becker (IZM) und R. Tjiburg (Philips).
[Bag88]	E. Bagda, „Zum Feuchtehaushalt von Beschichtungen“, farbe + lack 94 (1988) 8, 606-609.
[Ben06]	„Eigenschaftsbilder neuartiger Vergussmassen auf der Basis von Polyurethanen“, Seminarunterlagen OTTI-Fachforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 6./7. November 2006; OTTI-Kolleg.
[Ben07]	„Selection Criteria for Polyurethane Encapsulants in Electric and Electronic Applications“ Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, Mai 2007.
[Ben08]	„Properties of Polyurethane Potting Resins based on Chemical Composition“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Chicago, Oktober 2008.
[Ben09]	„Polyurethane Encapsulants in Electric and Electronic Applications requiring Flame-retardancy“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, Mai 2009.
[Ben10]	„Industrial use of Polyurethane Encapsulants in Coil Winding Applications“, Tagungsband <i>Inductica</i> , Berlin, June 2010.
[Bri08a]	J. Bridges, „Weg in die „grüne“ Zukunft – Eine neue Ära im Schutzlackbereich“, EPP, Heft 03/04 (2008) S. 26-27.
[Bri08b]	J. Bridges, A. Stuart, „Verlässlichkeit hoch, Kosten niedrig – Die Reinigung von Elektronik-Baugruppen ist unverzichtbar“, EPP, Heft 07/08 (2008) S. 30-32.
[Bün04]	K. Bünning, „Aspekte zur Erhöhung der Temperaturwechselbeständigkeit von Leiterplatten“, PLUS, 10, (2004).
[Ehr99]	G.W. Ehrenstein, „Polymer-Werkstoffe“, Hanser-Verlag, (1999).
[Ell89]	B.N. Ellis, „Reinigen in der Elektronik“, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (1989).
[Epp08b]	„Der Trend geht zur maschinellen Reinigung – Workshop zur Reinigung in der Elektronikfertigung“, EPP, Heft 07/08 (2008) S. 6-8.
[EriXX]	S. Erickson „Präzise Beschichtungstechniken für Conformal Coating Anwendungen“ unter www.gps-technologies.com bzw. „Precision coating deposition techniques for conformal coating applications“ unter www.ultraspray.com
[Fla10]	T. Fladung, „Korrosionsschutz elektronischer Baugruppen durch Schutzlackierungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 182-187.
[For08]	T.M. Forsythe, „Neue Methoden im Einzug – Bestimmung der Rückstandsfreiheit von Baugruppen mit geringen Boardabstand“, EPP, Heft 05/06 (2008) S. 62-65.
[Fra06]	J. Frank, „Auswahlkriterien für polyurethanbasierte Gießharzsysteme“, Seminarunterlagen OTTI-Fachforum „Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik“, 25./26. Januar 2006; OTTI-Kolleg.
[Fre99]	J. Freund, J. Halbritter, J.K.H. Körber, „How dry are Dried Samples? Water Adsorption Measured by STM“, Microscopy Research and Technique 44 (1999) 327-338.
[Fun89]	W. Funke, E. Fischer, „Haftfestigkeit organischer Beschichtungen auf Metallen bei Einwirkung von Wasser“, farbe + lack 95 (1989) 6, S. 403-407.
[Hab97]	G. Habenicht, „Kleben“, Springer-Verlag, (1997).
[HdT07]; [HdT10]	Tagungsunterlagen Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“, 22. März 2007 und 03. März 2010; Haus der Technik, Essen.

[Jil03]	W. Jillek, G. Keller, „ <i>Handbuch der Leiterplattentechnik</i> “, Band 4, Eugen G. Leuze Verlag, Bad Saulgau, (2003).
[Kai92]	W.-D. Kaiser, S. Pietsch, A. Rudolf, „ <i>Zusammenhänge zwischen Permeations- und Adhäsionsverhalten sowie der Unterrostung organischer Beschichtungen</i> “, farbe + lack 98 (1992) 3, 182-187.
[KamXX]	M.R. Kamal, R. Saxon, „ <i>Recent developments in the analysis and prediction of the weatherability of plastics</i> “, Applied Polymer Symposia, 4:1-2, 19678.
[Kli01]	W. Klingel, „ <i>Die Zukunft der Schutzbeschichtung</i> “, Productronic, Heft 03 (2001).
[Kli05a]	W. Klingel, „ <i>Vergusstechniken für den Schutz von Flachbaugruppen</i> “, PLUS, Heft 5, (2005) 893-901.
[Kli05c]	J.-H. Klingel, „ <i>Nässe, Säure, Schmutz & Co. – Sichre Funktion durch Verguss</i> “, Productronic, Heft 5-6 (2005) S. 30-31.
[Kli06a]	J.-H. Klingel, „ <i>Klimaausfälle sind vermeidbar</i> “, Productronic, Heft 05 (2006) S. 64-65.
[Kli09a]	J.-H. Klingel, „ <i>Allroundtalent – Schutzbeschichtungsanlagen für elektronische Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 08/09 (2009) S. 23-25.
[Knö03]	P.A. Knödel, „ <i>Partielle Beschichtung nichttauchfähiger Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 11 (2003).
[Län07]	M. Läntzsch, „ <i>Wie gefährlich sind Flussmittelrückstände? – Normen, Vorschriften, Grundlagen</i> “, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Lie01]	J. Lienemann, „ <i>Testverfahren, Qualifikation und EMV</i> “, IMTEK, Lehrstuhl für Simulation, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, (2001).
[Löw08]	R. Löw, J. Wilde, „ <i>Untersuchung zur Auswirkung von Feuchte auf elektrisch leitfähige Klebverbindungen</i> “, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 213-218.
[Luc73]	W.A.P. Luck, „ <i>Structure of Water and Aqueous Solutions</i> “, Verlag Chemie, Weinheim (1973).
[Man07]	O. Manger, H. Schweigart, „ <i>Wie sauber muss es sein? – Normen für die Reinigung von elektronischen Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 07 (2007) S. 18-21.
[Mar08]	B. March, A. Steinke, C. Matzner, C. Schimpf, „ <i>Ausfallverhalten elektronischer Baugruppen unter Betauungseinfluss</i> “, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 201-206.
[Mue07]	M. Müller, „ <i>Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethan - Verarbeitungsfehler und deren Vermeidung</i> “, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Neh05]	F. Nehmeier, „ <i>Feuchtigkeit und Schutzlackierung in der Kfz-Elektronik</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Nev04]	B. Neves, „ <i>Accelerating PTH Reliability Testing while reducing Cost</i> “, EIPC-Summer Conference 2004, Basel.
[Nol68]	W. Noll, „ <i>Chemistry and Technology of Silicones</i> “, Academic Press (1968).
[Ott05a]; [Ott06a]; [Ott07a]; [Ott10a]	Tagungsband (CD) OTTI-Profiforum „ <i>Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik</i> “, 16./17. März 2005; 06./07. November 2006; 20./21. Juni 2007; 16./17. Juni 2010, OTTI-Kolleg.
[Ott06b]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „ <i>Produktion bleifreier elektronischer Baugruppen</i> “, 05./06. April 2006; OTTI-Kolleg.
[Ott07b]; [Ott08a]; [Ott09a]; [Ott10a]	Tagungsunterlagen (CD) OTTI-Fachforum „ <i>Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen – Grundlagen, Technologien, Projektbeispiele</i> “, 14./15. März 2007; 02./03.04.2008; 01./02.04.2009; 24./25.03.2010; OTTI-Kolleg
[Pap06]	U. Pape, M. Rittner, T. Liebl, N. Neher, M. Nowotnick, „ <i>Untersuchung der Zuverlässigkeit hochtemperaturgeeigneter Baugruppen</i> “, GMM-DVS-Tagung, Fellbach, (2006).
[Pie92]	M. Piepho, „ <i>Sicherheitsaspekte bei der Gießharzverarbeitung</i> “, Elektrizitätswirtschaft, 91 (1992) 1760.

[Pie94]	M. Piepho, „Vergleich der Eigenschaften unterschiedlicher Kaltverguss-Systeme für elektrische Anwendungen (Energiebilanzen synthetischer und teilsynthetischer Vergussmassen)“, Elektrizitätswirtschaft, 93 (1994) 1682.
[Pie95]	M. Piepho, „Vergleich von Vergussmassen“, ETZ, 116, Heft 23-24 (1995) 22.
[Pie97]	M. Piepho, „Füllstoffe in Elektroisierstoffen“, ETZ, 118, Heft 6 (1997) 56.
[Pie01]	M. Piepho, „Unverzichtbar - Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik“, ETZ, Heft 16 (2001) 26-29.
[Pie03]	M. Piepho, „Unverzichtbar: Vergussmassen für Elektrotechnik und Elektronik“, PU-Magazin, Heft 4 (2003).
[Pie06a]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen“, etz, Heft 7 (2006) 44-47.
[Pie06b]	M. Müller, O. Bartels, M. Piepho, „Verarbeitung von Gießharzen auf Basis von Polyurethanen“, PU-Magazin, Heft Juni/Juli (2006) 125-130.
[Pie07a] [Pie10a]	M. Piepho, „Vergussmassen, PUR, Epoxid, Silikon, Kohlenwasserstoffharze“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007 bzw. 03. März 2010.
[Pol85]	<i>Polymer Permeability</i> , J. Comyn (ed.), Elsevier Applied Science, London (1985).
[Plu82]	E.P. Plueddeman, „ <i>Silicone coupling agents</i> “, Plenum Press, New York, (1982).
[Rie08]	J. Riess-Frohberg, A. Harein, „ <i>Neue Reinigungskonzepte helfen – Kostensparende Fehldruckreinigung</i> “, EPP, Heft 02/03 (2008) S. 34-35.
[Roc87]	E.G. Rochow, „ <i>Silicon and Silicones</i> “, Springer-Verlag, Heidelberg, (1987).
[Ros10]	G. Schulze, A. Rost, „Ressourceneffiziente Lackierung von Baugruppen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 188-192.
[Sche07]	W. Scheible, „ <i>Rechtliche Aspekte bei der Schutzbeschichtung elektronischer Baugruppen - Haftung</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Schm96]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Klimabedingte Ausfälle elektronischer Baugruppen: Prüfbarkeit und Schutzstrategien</i> “, 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal (1996) - Tagungsband, Karlsruhe: DWS Werbeagentur und Verlag, (1996), S. 14-1 bis 14-15.
[Schm97]	K.G. Schmitt-Thomas, S. Wege, H. Schweigart, „ <i>Wirksamkeit von Elektronik-Schutzlacksystemen gegen elektrochemische Migration und Kriechstrombrücken</i> “, in: Thomann (Hrsg.): <i>Werkstoffe für die Informationstechnik</i> . Frankfurt: DGM-Informationsgesellschaft, (1997) 151-155.
[Schu99]	G. Schulze, „ <i>Selektive und automatische Schutzbeschichtung von elektronischen Baugruppen</i> “, Productronic, Heft 07/08 (1999).
[Schu00]	G. Schulze, „ <i>Überragende Prozesskontrolle durch geschlossene Regelkreise</i> “, LP infos, Heft 11 (2000).
[Schu01a]	G. Schulze, „ <i>Berührungsloses Jet Dispensen in der Praxis</i> “, Productronic, Heft 03 (2001).
[Schu01b]	G. Schulze, „ <i>Automatische, selektive Beschichtung mit Dickschichtlacken</i> “, LP infos, Heft 04 (2001).
[Schu02a]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ Februar 2002, Frankfurt/M., Tagungsband.
[Schu02b]	G. Schulze, M. Reighard, „ <i>Automatisch Schutzbeschichten</i> “, Teil 1: Productronic Heft 05 (2002) 28; Teil 2: Productronic Heft 06 (2002) 48; Teil 3: Productronic Heft 07/08 (2002) 24.
[Schu03]	G. Schulze, „ <i>Automatische und selektive Schutzlackierung von bestückten Leiterplatten ohne zusätzliche Maskierarbeiten</i> “, GfKORR Tagung „Beschichtung elektronischer Baugruppen“ März 2003, Berlin, Tagungsband.
[Schu04]	G. Schulze, „ <i>Aktuelle Technologien für die automatische und selektive Beschichtung von bestückten Flachbaugruppen</i> “, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 303-308.
[Schu05a]	G. Schulze, „ <i>Prozessregelung bei automatisierten und selektiven Beschichtungsverfahren</i> “, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.

[Schu05b]	G. Schulze, „Mehr Zuverlässigkeit durch Schutzlackierung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2005).
[Schu05c]	G. Schulze, „Kontaktloses Dispensjet Verfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2005).
[Schu05d]	G. Schulze, „Prozessregelung bei automatischen Beschichtungsverfahren“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 11 (2005).
[Schu06]	G. Schulze, „Beschichtung mit Prozessregelung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2006).
[Schu07a]	G. Schulze, „Performance im Detail“, Productronic, Heft 01-02 (2007) 21-22.
[Schu07b]	G. Schulze, „Automatische Dosierung und Beschichtung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Schu07d]	G. Schulze, „Innovative Dosierverfahren mit integrierter Regelung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 07/08 (2007) S. 36-38.
[Schu07e]	G. Schulze, „Emissionsfreie Produktion“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 09 (2007) S. 22.
[Schu07f]	G. Schulze, „Coating und Dispensing Plattform neu definiert“, Productronic, Heft 12 (2007) S. 28-31.
[Schu07g]	G. Schulze, „Die Spectrum Plattform – Beschichtung und Dosierung in neuer Dimension“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 12 (2007) S. 30-31.
[Schu08a]	G. Schulze, „Pulsweitenmoduliertes Beschichtungsventil für die selektive Schutzbeschichtung und den Verguss von bestückten Flachbaugruppen“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 329-334.
[Schu09a]	„Punktgenau und reproduzierbar“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 01/02 (2009) S. 29-30.
[Schu09b]	„Innovative Lösungen im Dispensbereich“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2009) S. 62-63.
[Schu09c]	„Kleben und Beschichten in der Elektronikfertigung“, Adhäsion, April (2009) S. 14-17.
[Schu09d]	„Neue Technologien“, PLUS, Mai (2009) S. 1131-1137.
[Schu10a]	„Zuverlässiges Coating“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03/04 (2010) S. 34-35.
[Schw97a]	H. Schweigart, „Funktionssicherheit schutzlackierter elektronischer Baugruppen bei Feuchtklimabeanspruchung“, München, Hieronymus-Verlag, 1. Auflage (1997), 2. Auflage (1998).
[Schw97b]	H. Schweigart, S. Wege, „Prüfung von Lötstoppsmasken und Schutzlacken mittels thermischer Analyse“ (SMT ES&S Hybrid, Nürnberg 1997) - Tagungsband, Berlin: VDE-Verlag, 1997, S. 175-183.
[Schw98]	H. Schweigart, „Einfluss der Umgebungsbedingungen auf die Schutzwirkung von Elektronikschutzlacken“, 27. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1998), Tagungsband.
[Schw99a]	H. Schweigart, „Ausfälle im Feld: teuer und vermeidbar?“, Productronic, Heft 10 (1999).
[Schw99b]	H. Schweigart, „Die Schaden- und Schwachstellenanalyse als Instrument des Testtailoring für die Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 28. Jahrestagung der Gesellschaft für Umweltsimulation e.V., Pfinztal, (1999) Tagungsband.
[Schw00]	H. Schweigart, E. Christian, „Plus für hohe Zuverlässigkeit – Nachweis von Flussmittelrückstand und Aktivator auf Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2000).
[Schw01a]	H. Schweigart, „No clean und bleifrei: ein Widerspruch?“, Productronic, Heft 10 (2001) 1-2.
[Schw01b]	H. Schweigart, „Fehlursachen klimatisch beanspruchter Elektronikschaltungen“, SMT, Heft 04 (2001) 18-20.
[Schw03a]	H. Schweigart, S. Repp; „Oberflächenreinheit bei Bond- und Coating Prozessen“, JOT, Heft 11 (2003) 36-38.
[Schw03b]	H. Schweigart, S. Strixner, A. Mühlbauer; „Optimal Reinigen unter BGAs?“, Productronic, Heft 12 (2003).

[Schw03c]	S. Repp, H. Schweigart, „Zuverlässigkeit steigern – Reinigen in der Elektronikfertigung“, Metalloberfläche, Heft 11 (2003) 35-38.
[Schw03d]	H. Schweigart, „Brauchen Coatings Reinigung?“, VTE Verbindungstechnik in der Elektronik, 15, Heft 01 (2003) 20-24.
[Schw04]	H. Schweigart, „Reinheitsanforderungen und Reinigung vor der Beschichtung“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 321-325.
[Schw05]	H. Schweigart, „Oberflächencharakterisierung vor der Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Schw06a]	H. Schweigart, S. Strixner, „Coatings schnell und kostengünstig prüfen – Testmethode zur Überprüfung von Schutzlackierungen elektronischer Baugruppen“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 5-6 (2006) 96-97.
[Schw06b]	H. Schweigart, „Wenn der Lack abgeht – Mindestreinheit der Oberfläche vor der Schutzbeschichtung“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 10 (2006) 30-32.
[Schw07a]	H. Schweigart, D. Borgend, „Bauelemente-Vorbehandlung durch Reinigung“, Seminarunterlagen der Fachveranstaltung „Vergusstechnik für die Elektrotechnik und Elektronik“ im Haus der Technik, Essen, 22. März 2007.
[Schw08]	H. Schweigart, „Beschichtungsprobleme? – So hält ihr Lack!“, SMT 21 Heft 5 (2008) 22-25.
[Sei07]	A. Seiwert, T. Lauer, „Der Vorteil eines modernen Reinigungsprozesses“, SMT Germany, Heft 6-7 (2007) 19-20.
[Sei08]	A. Seiwert, „Reinigung von Flachbaugruppen als Vorbehandlung zum Klimaschutzüberzug“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 323-328.
[Sil89]	„Silicone: Chemie und Technologie“, Vulkan-Verlag, Essen, (1989).
[Sil01]	„Übersicht über die Silicon-Chemie“, Firmenschrift der Fa. Dow Corning Corp., (2001); veröffentlicht in erster Version von A. Colas unter dem Titel „La chimie des silicones“ in Chimie Nouvelle, Vol. 8 (30) (1990) 847.
[Ste07]	M. Stephan, „Silicones for Automotive Electronics Applications: Advances in Adhesives and Thermal Materials“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 21. Juni 2007, Berlin, Tagungsband.
[Sti07]	M. Stieglmeier, „Wie finde ich meinen optimalen Reinigungsprozess – Handlungsempfehlungen für die Wahl des richtigen Reinigungsequipments“, EPP, Heft 10 (2007) S. 36-39
[Str07]	S. Strixner, „In einem einzigen Prozess reinigen? – Bleifreie und bleihaltige Baugruppen“, Productronic, Heft 3 (2007) 28-31.
[Sup00]	M. Suppa, „Der Einsatz von Vergussmassen in der Elektronik“, Teil 1: PLUS, Heft 03 (2000), Teil 2: PLUS, Heft 06 (2000), Teil 3: PLUS, Heft 08 (2000).
[Sup01a]	M. Suppa, M. Kollasa „Dickschicht-Beschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – ein Widerspruch?“, PLUS, Heft 08 (2001) und Ref.-Nr. 152 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2001).
[Sup01b]	M. Suppa, „Dickschichtbeschichtungsstoffe und schnelle Schutzlackierprozesse – Dick aufgetragen, schnell getrocknet“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 04 (2001).
[Sup02]	M. Suppa, „Conformal coatings for Component Protection“, Circuits Assembly, Vol. 13, Heft 06 (2002).
[Sup03]	M. Suppa, „Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen“, VTE Aufbau- und Verbindungstechnik, Heft 01 (2003).
[Sup04a]	M. Suppa, „Die Schutzlackierung von elektronischen Baugruppen – von High-Solid-Lacken über wasser verdünnbare hin zu lösemittelfreien Schutzlacken“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 287-294 bzw. als Ref.-Nr. 159 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04b]	M. Suppa, „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima- und Kriechstromzuverlässigkeit“, Ref.-Nr. 160 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).
[Sup04c]	M. Suppa, „Ökologische Technologien und Beschichtungsstoffe für Leiterplatten“, Ref.-Nr. 155 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2004).

[Sup04c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeitsprüfungen und Ausfallmechanismen bei Lötstopplacken“, VdL, ZVEI – Panel Discussion, „Erhöhte Anforderungen an die Zyklenfähigkeit von elektronischen Baugruppen“, SMT 2004.
[Sup04d]	M. Suppa, „Temperaturstress – Auswirkungen auf Schutzlacke in der Elektronik“, Metalloberfläche, Heft 11 (2004) 35-38.
[Sup04e]	M. Suppa, „Der komplette Lifecycle ist entscheidend – Beschichtungsmaterialien für Leiterplatten aus ökologischer Sicht“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Heft 03 (2004).
[Sup05a]	R. Dietrich, P. Heuser, W. Peters, M. Suppa, „Schutzlacke und Vergussmassen als Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen“, Ref.-Nr. 150 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup05b]	M. Suppa, „Thermische Beständigkeit von Schutzlacken“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.
[Sup05c]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, PLUS, Heft 9, (2005) 1609-1615.
[Sup05d]	M. Suppa, „Temperaturstress und Temperaturwechsellasts – Auswirkung auf Schutz- und Lötstopplacksysteme“, Ref.-Nr. 161 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2005).
[Sup06a]	M. Suppa, „RoHS, ELV und WEEE und ihre Auswirkungen auf die Beschichtungsstoffe für die elektronische Industrie“, Ref.-Nr. 162 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).
[Sup06b]	M. Suppa, „Silikone als Beschichtungsstoffe in der Elektronik“, Ref.-Nr. 163 der Fa. Lackwerke Peters GmbH & Co KG, Kempen, (2006).
[Sup06c]	M. Suppa, „Zuverlässigkeit von fotostrukturierbaren Lötstopplacken für elektronische Baugruppen bei Belastung durch Temperaturdauerstress und Temperaturwechselstress“, DVS/DMM-Tagung, Fellbach, (2006) und PLUS, Heft 4, (2006) 659-666.
[Sup06d]	M. Suppa, „Temperaturresistente Schutzlacke“, EPP Elektronik Produktion & Prüftechnik, Teil 1: Heft 1/2 (2006); Heft 4 (2006).
[Sup06e]	M. Suppa, „Schnellste Prozessierung von Schutzlacken mit der UV-Technologie“, PLUS, Heft 6, (2006) 870-876.
[Sup06f]	M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Temperaturen und hohe Feuchte“, LPinfos, 40 (2006) 4-6.
[Sup06g]	M. Suppa, „The reliability of photoimageable solder resists“, Circuitree, (2006).
[Sup07a]	M. Suppa, „Schutzlacke zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, Seminarunterlagen zum OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, März 2007, Regensburg.
[Sup07b]	M. Suppa, „Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 1“, Productronic, Heft 7 (2007) S. 23-24.
[Sup07c]	M. Suppa, „Schutzlacke – Dickschicht-Beschichtungsstoffe und Applikationen – Teil 2“, Productronic, Heft 8/9 (2007) S. 27-29.
[Sup07d]	M. Suppa, „Conformal coatings and their increasing importance for a safe operation of electronic assemblies“, Circuit World, 33, Heft. 4 (2007).
[Sup08a]	M. Suppa, „Prüf- und Teststrategie Schutzlacke und Lotpasten und Prozesse“, GMM-Fachbericht Band 55 (ISBN 978-3-8007-3074-2) „Elektronische Baugruppen und Leiterplatten EBL 2008“, 4. DVS/GMM-Fachtagung, 13./14.02.2008, Fellbach, S. 157-164.
[Sup08b]	M. Suppa, T. Touré, „Feuchteschutz und Wärmeableitung bei LEDs durch Microverguss mit dem Dickschichtlack TWIN-CURE [®] “, Productronic, Sonderheft „light & building“, (2008).
[Sup08c]	M. Suppa, „Die thermische Analyse in der Lack- und Beschichtungsanalytik“, LPinfos, 44 (2008) 4-7
[Sup08d]	M. Suppa, „Deutlich erhöhte Schutzwirkung – Neues zu Dickschicht-Beschichtungsstoffen und ihren Applikationsprozessen“, EPP, Heft 9 (2008) S. 75-77
[Sup08e]	M. Suppa, „Schutzlackierung zur Verbesserung der Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, OTTI-Fachforum „Schutzmaßnahmen zur Klimasicherheit elektronischer Baugruppen“, 02.-03.04.2008 Regensburg, Tagungsband..
[Sup08f]	M. Suppa, „Feuchte bleibt draußen, Wärme wird abgeführt, LED-Schutz durch Mikroverguss“, productronic SPEZIAL Mai 2008.

[Sup09a]	M. Suppa, „Schutzbeschichtung für elektronische Baugruppen bei Belastung durch hohe Feuchte und Betauung“, PLUS, Heft 5 (2009) S. 110-121.
[Sup09b]	M. Suppa, „Beschichtungsstoffe für die Elektronikindustrie - WEEE, RoHS, ELV und EuP nehmen auf verschiedensten Ebenen Einfluss - Teil 1“, Elektronik, 7, (2009) S. 50-53.
[Sup09c]	M. Suppa, „Schutzlacke für Elektronik-Baugruppen in Hochvoltanwendungen: Sicherer Schutz auch bei hoher Feuchtebelastung und Betauung“, EPP Europe, Heft 09 (2009) S. 40-41.
[Sup10a]	M. Suppa, H. Leiner, J. Tekath, „Schutzlacke, Lötstopplacke und Vergussmassen - optische Anforderungen und Leistungsfähigkeit bei LED Anwendungen“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 111-119.
[Str10]	W. Strunz, H. Schweigart, „Impedanzspektroskopie als Werkzeug zur Qualitätssicherung von bestückten und unbestückten Leiterplatten“, EBL 2010, 5. DVS/GMM-Tagung, 24./25. Februar 2010, Fellbach, Tagungsband S. 129-135.
[Tae08]; [Tae09]	Seminarunterlagen Technische Akademie Esslingen, „Vergießen und Verkapseln in der Elektrotechnik und Elektronik“, 13./14. März 2008, 15./16. September 2009; Technische Akademie Esslingen, Ostfildern.
[Tau91]	C.J. Tautscher, „Contamination Effects on electronic products“ New York: M. Dekker, Inc., (1991).
[Teg98]	P.-E. Tegehall, „Impact of Contamination from Production Processes on the Reliability of Printed Board Assemblies“, Proc. Int. Conf. on Electronic Assembly: Materials and Process Challenges, pp. 69-80, (1998).
[Tut04]	Unterlagen zum Tutorial 25 „Reinheit und Beschichtung elektronischer Baugruppen – Klima und Kriechstromzuverlässigkeit“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 15.-17.06.2004.
[Tut06]	Unterlagen zum Tutorial 24 „Die Schutzbeschichtung und ihre steigende Bedeutung für den sicheren Betrieb von elektrischen Baugruppen“ – SMT HYBRID PACKAGING, Nürnberg, 30.05. bis 01.06.2006.
[Weg00]	S. Wege, „Korrosionserscheinungen auf elektronischen Baugruppen unter Klimabeanspruchung“, Materials and Corrosion, 51, Heft 1 (2000) 7-12.
[Wei09a]	Franziska Weichhaus, „Aufbereiten, Dosieren und Vergießen von Vergussmassen unter Vakuum“, Adhäsion, Ausgabe 6/2009, S. 31-35.
[Wei10a]	Franziska Weichhaus, „Aufbereiten, Dosieren und Vergießen von Vergussmassen“ unter www.scheugenpflug.de / news / presse
[Zas04]	H. Zastrow, K.-W. Lienert, G. Schmidt, „Lösemittelfreie Beschichtungen“, in: DVS/GMM (Hrsg.), GMM-Fachbericht, Band 44 „Elektronische Baugruppen“, Vorträge der DVS/GMM-Fachtagung 04./05. Februar 2004 in Fellbach; S. 317-320.
[Zas05]	H. Zastrow, „Lösemittelfreie Beschichtung“, GfKORR-Seminar „Beschichtung elektronischer Baugruppen“, 09. Juni 2005, Berlin, Tagungsband.

Außerdem werden in folgenden Firmenschriften regelmäßig Artikel zur Thematik der Anwendung und Erzeugung von Schutzbeschichtungen bzw. zum Verguss von elektronischen Baugruppen veröffentlicht:

- **Coating Newsletter**

(Kundeninformation der Fa. KC Produkte GmbH; www.kc-produkte.com; erscheint zwei- bis dreimal im Jahr)

- **LPinfos**

(Kundenzeitschrift der Fa. Lackwerke Peters GmbH + Co. KG; www.peters.de; erscheint zweimal pro Jahr)

- **Scheugenpflug update**

(Kundenzeitschrift der Fa. Scheugenpflug AG; www.scheugenpflug.de; erscheint zweimal pro Jahr)

- **ZESTRON news**

(Kundeninformation der Fa. Zestron; www.zestron.com; erscheint dreimal pro Jahr)